

中信证券股份有限公司
关于深圳清溢光电股份有限公司
2026 半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“清溢光电”或“公司”或“上市公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、股东会及董事会议事规则等公司治理制度、股东会及董事会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账；

（5）对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与公司相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 核心竞争力风险

1、产品与技术国际竞争力暂不领先的风险

我国掩膜版产业相较于国际竞争对手起步较晚，历经二十余年持续技术追赶，国内掩膜版产品与国际同行在新品迭代节奏、产品性能指标等方面的差距已逐步缩小。当前国内掩膜版市场需求旺盛，公司虽为国内规模领先、技术水平位居前列的掩膜版厂商，但产品在国内中高端掩膜版市场的占有率仍不高，低于国际竞争对手，公司在两大赛道的技术指标表现分化。

平板显示掩膜版领域，公司产品精度已达到国际主流水平，但在 AMOLED、Mini/Micro LED 等新型显示专用掩膜版的精细化工艺、良率管控等关键环节，与国际顶尖厂商相比仍存在细微差距；半导体掩膜版领域，公司 55nm Binary 工艺节点虽已通过客户验证，但仅能满足国内成熟芯片制造、封装及器件应用需求，产品核心精度指标与国际先进水平存在一定差距。

2、关键技术人才流失风险

掩膜版行业属于典型技术密集型产业，且平板显示、半导体芯片两大赛道的技术路径、工艺要求差异显著，对专业化、复合型核心人才依赖度极高。行业内技术人才需历经长期工艺沉淀，既要精通光阻涂布、激光光刻、蚀刻等全流程生产工艺，又要深度贴合下游面板、芯片行业的需求迭代，人才培养周期长、市场

供给极度稀缺。现有团队虽支撑现有业务开展，但随着公司业务扩张、募投项目落地，人才缺口逐步显现。

（二）经营风险

1、主要设备和原材料均依赖进口的风险

公司主要原材料为掩膜版基板，且主要由境外供应商提供。公司主要生产设备光刻机均向境外供应商采购，且供应商集中度较高，主要为瑞典 Mycronic、德国海德堡仪器两家公司，其中最高端的平板显示用光刻机由瑞典 Mycronic 生产，全球主要掩膜版制造商对其生产的设备都存在较高程度依赖。公司存在主要设备和原材料均依赖进口的风险。未来，如果公司的重要原材料、主要设备与备件发生供应短缺、价格大幅上涨，或者供应商所处的国家和地区与中国发生贸易摩擦、外交冲突等进而影响到原材料、主要设备与备件的出口许可，将会对公司生产经营产生不利的影响。

2、产品质量控制的风险

公司主要产品掩膜版是下游电子元器件行业生产制造过程中的核心模具，是下游产品精度和质量的决定因素之一。公司根据与客户签订的销售合同/订单，向客户提供符合其品质指标要求的产品，如果未来公司出现重大产品质量事故，将可能面临客户根据销售合同约定要求公司给予相应赔偿或中断与公司业务合作的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、重资产经营的风险

公司所处掩膜版行业为资本密集型行业，主要生产设备昂贵，固定成本投入较大，存在重资产经营的风险。随着公司经营规模扩大和产品结构升级，公司积极对生产线进行改造升级，目前公司固定资产使用情况良好，核心生产设备产能利用率较高，但未来如果出现下游客户需求大幅减少，公司销量大幅降低的情形，或新增产能消化不及预期，将可能导致公司产能过剩的风险，则佛山生产基地等新增固定资产折旧也将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

4、主要客户相对集中的风险

公司向前五大客户销售金额较高，销售客户相对集中。如果未来公司主要客户经营状况出现不利变化或主要客户对公司产品需求下降，将可能对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。

5、盈利能力下滑的风险

掩膜版行业特点属重资产经营，佛山生产基地项目投资较大，未来公司工厂厂房、设备折旧等固定成本增加。若行业竞争程度进一步加剧、受宏观经济影响导致下游市场需求出现下滑、原材料价格波动、高端产品开发及客户认证不达预期、公司未能进一步提升竞争优势、产能利用率未能提升到较高水平，则公司存在盈利能力持续下滑的风险。

（三）财务风险

1、偿债能力风险

高财务杠杆会使公司负债率高，如果公司经营不善，偿还能力不足，可能出现违约风险，甚至危及公司生存。

2、经营风险

高财务杠杆会使公司的经营风险增加，公司需要支付更多的利息和本金。

3、市场风险

公司负债过多，如果市场发生变化，公司债务负担就会增加，例如：市场需求下降、价格大幅波动等因素都会对公司产生影响。

4、信用风险

若公司的财务杠杆过高导致公司信誉受损，将导致债权人失去信心，进而导致融资成本上升，公司融资难度将会加大。

5、汇率风险

公司主要原材料采购采用日元结算，主要设备采购采用美元结算，如果日元或美元汇率发生较大波动，将对公司业绩产生一定影响。

（四）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

近年来随着平板显示和半导体产业的快速发展，掩膜版市场需求旺盛。目前行业内竞争对手主要有美国的福尼克斯、日本的 TOPPAN、SKE、HOYA、DNP、韩国的 LG-IT、中国台湾的台湾光罩和中国大陆的掩膜版企业，行业集中程度较高。随着下游产业向中国大陆不断转移，未来将导致市场竞争加剧，对公司的经营业绩产生一定的影响。

2、下游平板显示行业发展变化的风险

平板显示掩膜版对公司报告期内经营业绩的影响较大。平板显示行业对掩膜版的需求量主要受到其研发活动活跃度、新产品开发数量、下游产品迭代周期、液晶面板产线数量、终端电子产品的市场需求等因素的影响，若下游平板显示行业发展发生不利变化，从而导致其对平板显示掩膜版的需求量减少，将会对公司的业绩产生不利影响。

3、下游产业结构调整风险

公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控以及电路板行业，目前上述行业在全球范围内呈快速发展态势，且有加快向中国大陆转移的趋势。随着消费电子产品技术革新、消费者偏好及市场热点的变化，公司下游产业可能出现结构性调整，各细分行业市场对掩膜版的需求结构可能发生较大变化，如果公司不能迅速觉察并调整产品思路以适应该等变化，将会对公司的业绩以及长远发展产生一定的不利影响。

4、技术替代的风险

目前全球范围内平板显示、半导体、触控等行业基本都采用掩膜版作为基准图案进行曝光复制量产，无掩膜光刻技术精度低，主要用于电路板行业。掩膜版光刻制作技术通常分为激光直写法和电子束直写法。激光直写法使用波长为 193nm、248nm、365nm、413nm 等的连续或脉冲激光光源，整形精缩成为 200~500nm 的激光点在掩膜光刻胶上画出电路图案后，通过显影蚀刻获得电路图案；电子束直写法使用小至纳米级的电子束斑为笔，在掩膜光刻胶上画出电路图案，掩膜版上的电子束胶在曝光显影后，通过湿法或干法蚀刻获得电路图形。公

司目前主要采用激光直写法生产掩膜版，逐步掌握电子束光刻技术，但随着科学研究的进步，不排除会出现新的无掩膜光刻技术对原有的工艺技术形成替代，从而产生技术替代风险。

（五）宏观环境风险

1、宏观经济波动带来的风险

掩膜版主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具，下游领域的发展情况较大程度上影响到掩膜版产品的供求变化。近年来，中国掩膜版行业受益于下游应用领域的良好发展态势，保持了一定的增长，而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。全球宏观经济的波动风险，将可能对公司的生产经营造成不利影响。

2、美国《芯片和科学法案》带来的风险

美国针对中国半导体产业的发展采取了技术出口管制、禁售高端光刻机和软硬件配套设施、向中国科技企业施加“芯片禁令”及组织“芯片联盟”等措施，体现出了美国对中国半导体产业的管制，以达到阻碍和延缓中国半导体产业在“先进制程”升级的步伐，相关措施对中国半导体产业的发展带来了诸多不确定性，可能对公司半导体芯片掩膜版的技术升级、设备引进、材料进口和市场开发带来不确定性风险，将可能对公司的生产经营造成不利影响。

3、主要原材料出口国（地区）和主要产品进口国（地区）政策调整风险

公司掩膜版产品的主要原材料掩膜版基板的境外供应商集中在日本、韩国和中国台湾。若未来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展，限制掩膜版基板的出口或制造贸易摩擦，将可能对公司的生产经营造成不利影响。

公司的掩膜版产品部分出口，主要销往中国台湾、新加坡。若未来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展，调整掩膜版产品进口政策，将可能对公司掩膜版产品销售造成不利影响。

4、环境保护的风险

公司生产经营中产生废液、废水、废气等环境污染物，报告期内，公司不存

在因违反环境保护相关法律、法规而受到重大处罚的情形。未来随着国家环境保护政策进一步完善，环保标准亦可能逐步提高，如果公司无法达到相应的环保要求或出现重大环保事故，将可能产生因违反环境保护法律、法规而受到相关部门处罚的风险，对公司生产经营造成不利影响。

5、停电的潜在风险

国内外宏观经济、燃料供应、气温和降水等多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。未来如果出现大面积限电或停电情况，可能存在导致生产基地停产的风险，对公司的生产运营造成影响。

6、日元汇率波动带来的风险

1) 原材料采购绝大部分以日元计价，如汇率大幅波动会导致成本的大幅波动。

2) 日韩竞争对手产品以日元计价，如汇率大幅波动可能会导致竞争力减弱。

7、关税政策带来的风险

美国对中国商品加征关税（包括部分半导体相关产品）对中国掩膜版企业带来了短期成本上升、供应链调整重构、出口市场受限的风险。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	65,361.26	62,203.02	5.08
归属于上市公司股东的净利润	11,795.21	9,203.76	28.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,812.29	8,289.50	30.43

经营活动产生的现金流量净额	26,652.93	15,161.66	75.79
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	286,838.21	277,860.69	3.23
总资产	428,643.48	392,876.04	9.10
主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.38	0.29	31.03
稀释每股收益 (元 / 股)	0.38	0.29	31.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.34	0.26	30.77
加权平均净资产收益率 (%)	4.16	4.79	减少0.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.81	4.31	减少0.50个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.70	4.00	增加0.70个百分点

利润总额和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 30.10%和 30.43%，主要系本期财务费用（汇兑收益）大幅增加所致、提质增效带动毛利率提升等因素共同导致；

经营活动产生的现金流量净额同比增长 75.79%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长 31.03%、31.03%和 30.77%，主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润增长所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

掩膜版行业竞争激烈，大多数客户都有多家掩膜版供应商。公司的竞争能力主要来源于公司通过先进技术生产高质量的产品、提供及时的交货期、有竞争力的价格和快速响应的服务，这是客户选择公司作为掩膜版供应商的主要因素。

1、深耕自主技术创新，夯实核心竞争根基

公司为国家高新技术企业，深耕掩膜版技术研发多年，以自有研发中心为核心载体，拥有深圳市光掩膜研发中心和广东省光掩膜工程技术研究开发中心，构建起覆盖设计、工艺、产品全流程的一体化技术开发体系；凭借硬核研发实力与行业贡献，公司于 2022 年成功入选国家专精特新“小巨人”企业，并于 2025 年顺利通过复审，创新资质与行业地位获得权威认可。同时，公司作为《薄膜晶体管（TFT）用掩模版规范》行业标准起草单位，深度参与行业规范编制与修订，引领行业技术标准化、规范化发展。

核心产品研发领域成果丰硕、高端化布局持续深化。2016 年 10 月成功攻克 AMOLED 用高精度掩膜版技术，跻身全球具备该品类量产能力的企业行列，打破国内相关产品完全依赖进口的格局，现已实现向多家国内主流面板企业稳定供货；8 代 TFT LCD 掩膜版凭借技术先进性，荣获 2019 年度深圳市科技进步奖二等奖；近年来持续攻坚前沿显示技术，成功实现 G8.6 代 OLED 掩膜版的技术研发与规模化量产，高端产品矩阵进一步完善。子公司合肥清溢专注高精度掩膜版研发，设立专属光掩膜技术研发中心，获评 2023 年度合肥市认定企业技术中心，同年获得安徽省专精特新中小企业资质；2022 年圆满完成国家基础产业再造和制造业高质量发展专项——8.5 代及以下高精度掩膜版项目攻关，2024 年紧贴客户市场需求，顺利完成中高端半透膜掩膜版（HTM）的技术研发与规模化量产，2025 年启动 PSM 相移掩膜版产品研发，持续夯实高端掩膜版技术与产能优势。

除产品技术研发外，公司在精密设备自研领域亦具备突出优势，专设设备研发中心，依托多年技术沉淀与经验积累，逐步掌握测量、修补、贴膜等核心设备的自主研制与运维能力，有效降低生产运营成本，构筑了独具特色的差异化竞争优势。

与此同时，公司拥有行业领先的图形设计与工艺处理能力，选用行业领先设计软件作为技术支撑，并结合多年生产实践经验与客户个性化需求，开展针对性二次开发，大幅提升软件在掩膜版领域的适配性与应用效率。依托优化后的系统平台，公司可精准完成产品工艺参数设计规则校验、图形元素符合性核查，自动实现图形逻辑处理、优化及对比分析，全方位保障工艺稳定性，显著提升掩膜版产品的整体制程质量。

2、国内领先的规模优势，产品矩阵不断丰富，迈向高端化

公司是国内规模领先的掩膜版产品与服务综合提供商，具备掩膜版全流程设计、研发、制造及销售能力，构建了多元化、全覆盖的优质产品矩阵，业务深度绑定平板显示、半导体芯片两大核心赛道，产品广泛应用于平板显示、触控、柔性电路、集成电路封装（IC Bumping）、集成电路代工（IC Foundry）、集成电路载板（IC Substrate）、MicroLED 芯片、微机电（MEMS）等细分领域，可全方位满足下游客户多样化、定制化需求。

依托成熟技术积累与规模化生产工艺，公司聚焦中高端产品产能扩张与结构升级，持续推进高端掩膜版国产替代进程。平板显示领域，已实现 8.6 代 OLED 用掩膜版、8.6 代高精度 TFT 用掩膜版、6 代中高精度 AMOLED/LTPS 掩膜版、中高端 HTM 掩膜版的稳定量产；同步规划产线扩容，重点提升 AMOLED、HTM 掩膜版产能，新增 PSM 掩膜版生产能力，加码 AR/VR 等高端显示掩膜版布局，加快 HTM、OPC、PSM 等前沿技术产品的研发量产，填补国内高端产品技术空白。

半导体芯片领域，公司 55nm Binary 工艺节点已通过客户验证，同步推进 130nm - 40nm PSM、OPC 工艺掩膜版开发，布局 28nm 半导体芯片掩膜版工艺研发。公司已掌握电子束光刻、干法蚀刻等中高端掩膜版核心关键工艺，为后续产品升级与技术迭代筑牢基础，助力国内半导体产业链国产化率提升与自主可控。

3、利用区域优势，为国内客户提供更贴身、更周到、更及时的服务

掩膜版行业对交付时效、响应速度及售后服务要求严苛，且大尺寸、高精度产品运输难度大，区位优势成为核心竞争要素之一。公司构建了深圳、合肥、佛山三大生产基地运营格局，实现对国内核心下游产业集群的就近配套，形成全域覆盖的区位优势。

相较于国际竞争对手，公司凭借短距离运输、便捷物流配送的优势，大幅缩短交付周期、降低运输损耗，实现对国内客户的快速响应；针对客户产品使用过程中的返清洗、返修、补贴膜等售后需求，本地化服务团队可第一时间对接解决，

提供贴身、周到、高效的全周期服务。同时，合肥、佛山基地配备高精度生产检测设备与智能化无人净化车间，随着合肥基地扩产落地、佛山基地量产推进，公司产能规模与工艺精度持续升级，进一步筑牢产业链国产化支撑能力，提升客户服务质量。

4、良好的行业口碑及优质的客户资源，积累了大批知名客户

公司凭借高品质产品、高效交付能力与专业服务，在掩膜版行业树立了良好的品牌口碑，与下游平板显示、半导体芯片领域头部企业建立了长期稳定的战略合作关系，客户资源优质且结构多元，为经营稳定性与持续发展提供坚实保障。

平板显示领域，公司核心客户涵盖京东方、维信诺、惠科、天马、华星光电、信利、龙腾光电、群创光电、华佳彩等国内知名面板企业；半导体芯片领域，成功开拓芯联集成、中车时代、比亚迪半导体、北京燕东微、粤芯半导体、三安光电、长电科技、通富微电、艾克尔、士兰微、泰科天润、积塔半导体、捷捷微电、斯达半导体、赛微电子等优质客户。随着合作深度不断加强，公司与客户的产品合作范围持续拓展，形成了互利共赢、长期共生的产业生态。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变化幅度（%）
费用化研发投入	3,074.59	2,485.03	23.72
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	3,074.59	2,485.03	23.72
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.70	4.00	增加 0.70 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

公司研发支出不存在显著变化。

（二）研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	微晶铬版产品工艺开发	500.00	189.23	524.29	已完成	微晶铬板平整度 $\leq 30\ \mu\text{m}$ ，CD 精度 $\leq 0.5\ \mu\text{m}$ ，透过率 $\geq 95\%$	制造工艺改良	应用于生产
2	异行厚胶铬版产品工艺开发	500.00	261.23	261.23	工艺开发阶段	厚胶掩膜版开发，经过工艺开发，实现产品多条工艺路线开发	制造工艺改良	应用于生产
3	下单自动化程序开发	400.00	173.46	173.46	软件开发阶段	开发自动化程序，对接 Tooling 系统接口，按客户模板匹配导出订单核心数据（如产品型号、数量、交期）	制造工艺改良	应用于生产
4	Metal Mask 补偿控制矩阵生成自动化	400.00	198.90	198.90	软件开发阶段	完全实现 METAL MASK 订单所有现有类型的 DC 补偿数据自动生成	制造工艺改良	应用于生产
5	Cr 系-PSM 蚀刻工艺抓取项目	1,200.00	196.42	768.54	工艺开发阶段	完成 Cr 系-PSM 蚀刻工艺准备	核心技术突破	应用于生产
6	高性能制造与重大装备研发专项	3,100.00	0.73	0.73	工艺开发阶段	完成产业链国产化	核心技术突破	应用于生产
7	6 代 OLED-HTM 产品开发项目	400.00	195.25	195.25	工艺开发阶段	完成 6 代 OLED-HTM 产品的开发	核心技术突破	应用于生产
8	光刻机光刻能力提升	350.00	173.61	173.61	工艺开发阶段	达到光刻效率提升幅度 1h/pcs,con 光刻能力 $1.8\ \mu\text{m}$	核心技术突破	应用于生产
9	高透 HTM（Array HTM）清洗最佳工艺定型项目	300.00	187.93	187.93	工艺开发阶段	确定高透 HTM（Array HTM）清洗最佳工艺	制造工艺改良	应用于生产

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
10	Cr 系-PSO 产品工艺打通项目	400.00	136.49	136.49	工艺开发阶段	完成 PSO 产品全流程打通,达到可量产状态	核心技术突破	应用于生产
11	全系产品 OR 模拟功能应用	500.00	202.25	202.25	工艺开发阶段	实现所有产品 OR 功能模拟	制造工艺改良	应用于生产
12	DC 类产品、混排类产品 PA 提升开发项目	120.00	88.58	88.58	工艺开发阶段	采用工艺提升实现 DC 类产品、混排类产品 PA 提升	制造工艺改良	应用于生产
13	外观类 mura 分析与控制改善项目	100.00	88.97	88.97	工艺开发阶段	通过分析及控制,对外观类 Mura 进行改善	制造工艺改良	应用于生产
14	清洗机掩膜版边缘白点改善项目	120.00	104.76	104.76	工艺开发阶段	通过工艺提升,改善清洗机掩膜版边缘白点问题	制造工艺改良	应用于生产
15	清洗机掩膜版中心铬发白改善项目	120.00	94.65	94.65	工艺开发阶段	通过工艺提升,对掩膜版中心铬发白问题进行改善	制造工艺改良	应用于生产
16	Multi-DB 的 Boolean 开发	300.00	119.24	119.24	软件开发阶段	实现高节点订单的单层数据使用多个文件的复杂 Boolean 运算	制造工艺改良	应用于生产
17	130nm PSM 工艺研发	250.00	167.72	250.55	已完成	1、Phase Angle: 180 度 $\pm$ 3 度 2、Transmittance at 248nm: 6% $\pm$ 0.3% 3、CD (on mask): $\leq 0.52 \mu m$ 4、C.D. Tolerance: $\pm 0.02 \mu m$	核心技术突破	应用于生产
18	Automatic-CD 功能的开发	300.00	111.93	111.93	软件开发阶段	检查客户 CD-SEM 数据的正确性,并将 CD-SEM 数据转换成测量机台可识别的数据	制造工艺改良	应用于生产
19	超高精度产品 CD MTT 提升项目	300.00	103.04	285.77	已完成	采用专用工艺,制作高精度点检表对应相应产品工艺,不同线宽使用不同 BIAS 来补偿 CD 线性问题	制造工艺改良	已应用于生产
20	IC mask 一次清洗率提升项目	150.00	54.61	162.29	已完成	通过优化清洗 Recipe、优化工艺参数,强化机台清洁等来实现一次清洗通过率提升	制造工艺改良	已应用于生产

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
21	LCVD250 修补机研发项目	250.00	79.61	122.59	中试阶段	1、实现缺陷尺寸 $\geq 2\mu\text{m}$ 补的能力 2、实现缺陷尺寸 $\geq 0.7\mu\text{m}$ 修的能力	核心技术突破	应用于生产
22	基于电子束直写技术的工艺开发	80.00	41.16	88.31	已完成	通过引入电子束直写技术，实现对光掩模的 CD 线宽控制以及邻近效应产生的误差补正，达到最优线性控制，从而优化其产品特性	核心技术突破	应用于生产
23	基于干法蚀刻工艺的工艺开发	80.00	43.94	83.16	已完成	研究开发全新光阻干法刻蚀技术，并通过引入含有 MoSi 材料的基板改变光刻胶的相位差，达到最优线性控制、最优缺陷控制以及最小技术节点的目标	核心技术突破	应用于生产
24	制程精度检测能力拓展和提升	80.00	39.29	75.61	已完成	改善测量系统性能与稳定性，提升制造过程中精度数据获取效率，优化工艺适配性，全面强化制程精度检测能力	核心技术突破	应用于生产
25	高精度 AOI 检测工艺开发	100.00	3.60	3.60	工艺开发阶段	通过工艺开发，完成高精度 55nm 用掩膜版 AOI 检测工艺开发	核心技术突破	应用于生产
26	9035 高精度 mask 产品开发	100.00	3.60	3.60	工艺开发阶段	通过工艺开发，对于 9035 特殊尺寸 mask 产品，完成全套工艺开发	核心技术突破	应用于生产
27	AMIS 仿真技术工艺技术开发	100.00	3.60	3.60	工艺开发阶段	通过工艺开发，完成 55nm 用掩膜版 AMIS 仿真技术工艺技术开发	核心技术突破	应用于生产
28	高节点半导体修补工艺技术开发	100.00	3.60	3.60	工艺开发阶段	通过工艺开发，完成 55nm 用掩膜版修补工艺技术开发	核心技术突破	应用于生产
29	基于 PSM 产品的涂胶工艺技术开发	100.00	3.60	3.60	工艺开发阶段	基于 PSM 产品，通过工艺开发，实现二次涂胶工艺技术开发	核心技术突破	应用于生产
30	基于 PSM 产品的相位测量工艺技术开发	100.00	3.60	3.60	工艺开发阶段	基于 PSM 产品，通过工艺开发，实现 PSM 相位测量工艺技术开发	核心技术突破	应用于生产

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
合计	/	10,900.00	3,074.59	4,520.68	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

姓名	身份/职务	期初直接持股数（股）	期末直接持股数（股）	期间内股份增减变动量	增减变动原因
光膜（香港）有限公司	控股股东	73,977,300	73,977,300	0	/
唐英年	实际控制人	0	0	0	/
唐英敏	实际控制人	0	0	0	/
	董事				
	董事长				
唐庆年	董事	0	0	0	/
唐嘉盛	董事	0	0	0	/
张百哲	董事	0	0	0	/
	副董事长				
庄鼎鼎	董事	0	0	0	/

姓名	身份/职务	期初直接持股数（股）	期末直接持股数（股）	期间内股份增减变动量	增减变动原因
	副董事长				
谢景云	董事	0	0	0	/
姜巍	职工代表董事	0	0	0	/
	总经理				
高术峰	独立董事	0	0	0	/
王漪	独立董事	0	0	0	/
陈建惠	独立董事	0	0	0	/
许建笙	独立董事	0	0	0	/
李跃松	技术总裁、核心技术人员	0	0	0	/
任新航	董事会秘书、财务总监	0	0	0	/
合计		73,977,300	73,977,300	0	/

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

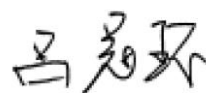
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司 2026
半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:



于丽华



吕冠环

